

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01347)

新聞稿

二零二六年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2026年5月14日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二六年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二六年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入達 6.609 億美元，同比增長 22.2%，環比增長 0.2%。
- 毛利率 13.0%，同比上升 3.8 個百分點，環比持平。
- 母公司擁有人應占利潤 2,090 萬美元，同比上升 458.1%，環比上升 19.9%。

二零二六年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約在 6.9 億美元至 7.0 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 14%至 16%之間。

總裁致辭

華虹半導體董事會主席兼總裁白鵬博士對公司二零二六年第一季度業績評論道：

“華虹半導體二零二六年第一季度實現銷售收入 6.609 億美元，同比增長 22.2%；毛利率為 13.0%，同比上升 3.8 個百分點。兩項指標均符合指引預期。本季度母公司擁有人應占利潤達 2,090 萬美元，同比大幅增長。在產能快速爬坡的同時，公司依舊保持高產能利用率，各工藝技術平臺均表現強勁；其中 MCU、獨立式閃存以及 BCD 工藝產品增長最為顯著。得益於公司在降本增效方面的持續努力，以及自季度初開始顯現並在整個季度不斷增強的積極需求信號，公司業績表現穩健。”

白總繼續表示：“隨著人工智能及相關應用在行業發展和市場格局中的作用日益增強，全球半導體產業正加速演變。人工智能對全球半導體市場需求的顯著拉動，與全球供應鏈格局持續存在的不確定性交織，共同構成了我們當前所面對的更加複雜的市場環境。華虹半導體始終堅守特色工藝晶圓代工龍頭企業的戰略目標，持續聚焦市場需求、不斷強化工藝能力並提升產能規模。第一季度，公司 12 英寸產能爬坡穩步推進、收入占比已提升至 62.7%；8 英寸產線繼續保持良好盈利能力。與此同時，擬議收購華力微事項已獲上交所受理並進入實質審核階段，正在按照既定計劃推進，預期可於今年下半年完成。最後，作為一名深耕行業多年的半導體從業者，我始終對全球及中國半導體產業的未來充滿信心。我將全力推動華虹半導體不斷提升行業地位和影響力，並為股東創造持久價值。”

電話會議公告

日期 2026 年 5 月 14 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

05:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，董事會主席兼總裁
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/hzh37nq7> 作線上直播
(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN
(個人身份識別碼)。

<https://register-conf.media-server.com/register/Blcb1a74a561af4a9393c1c207872566c1>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共用您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	660,925	540,937	659,882	22.2 %	0.2 %
毛利	86,059	49,997	85,464	72.1 %	0.7 %
毛利率	13.0 %	9.2 %	13.0 %	3.8	-
經營開支	(105,613)	(97,110)	(130,165)	8.8 %	(18.9)%
其他(損失)/收入淨額	(2,448)	(8,294)	34,110	(70.5)%	(107.2)%
稅前損失	(22,002)	(55,407)	(10,591)	(60.3)%	107.7 %
所得稅抵免/(開支)	4,735	3,245	(8,069)	45.9 %	(158.7)%
期內損失	(17,267)	(52,162)	(18,660)	(66.9)%	(7.5)%
淨利潤率	(2.6)%	(9.6)%	(2.8)%	7.0	0.2
以下各方應占：					
母公司擁有人	20,929	3,750	17,454	458.1 %	19.9 %
非控股權益	(38,196)	(55,912)	(36,114)	(31.7)%	5.8 %
持有人應占每股盈利					
基本	0.012	0.002	0.010	500.0 %	20.0 %
攤薄	0.012	0.002	0.010	500.0 %	20.0 %
付運晶圓(折合 8 吋千片)	1,453	1,231	1,448	18.0 %	0.3 %
產能利用率 ¹	99.7%	102.7 %	103.8 %	(3.0)	(4.1)
淨資產收益率 ²	1.2 %	0.4 %	1.2 %	0.8	-

二零二六年第一季度

- 銷售收入達 6.609 億美元，同比增長 22.2%，主要得益於付運晶圓數量上升及平均銷售價格上漲；環比增長 0.2%。
- 毛利率 13.0%，同比上升 3.8 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及降本增效；環比持平。
- 經營開支 1.056 億美元，同比上升 8.8%，主要由於無錫新生產線的營運費用上升；環比下降 18.9%，主要由於人工開支下降。
- 其他損失淨額 240 萬美元，同比減少損失 70.5%，主要由於本期取得外幣匯兌收益而上年同期為外幣匯兌損失，部分被政府補貼及利息收入減少和財務費用上升所抵消；上季度為其他收入淨額 3,410 萬美元，主要由於財務費用上升及政府補貼下降。
- 所得稅抵免 470 萬美元，由於本期轉回 2025 年度計提的代扣代繳股息稅。
- 期內損失 1,730 萬美元，同比減虧 66.9%，環比減虧 7.5%。
- 母公司擁有人應占利潤 2,090 萬美元，同比上升 458.1%，環比上升 19.9%。
- 基本每股盈利 0.012 美元。
- 淨資產收益率（年化）1.2%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二六年 第一季度 % (未經審核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
晶圓	635,843	96.2 %	515,574	95.3 %	120,269	23.3 %
其他	25,082	3.8 %	25,363	4.7 %	(281)	(1.1)%
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度 96.2%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二六年 第一季度 % (未經審核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圓	246,380	37.3 %	231,086	42.7 %	15,294	6.6 %
12 吋晶圓	414,545	62.7 %	309,851	57.3 %	104,694	33.8 %
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.464 億美元及 4.145 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二六年 第一季度 % (未經審核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
中國 ³	525,209	79.5 %	442,458	81.8 %	82,751	18.7 %
北美 ⁴	85,701	13.0 %	56,427	10.4 %	29,274	51.9 %
亞洲其他 ⁵	28,211	4.2 %	26,824	5.0 %	1,387	5.2 %
歐洲	21,804	3.3 %	15,228	2.8 %	6,576	43.2 %
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 5.252 億美元，占銷售收入總額的 79.5%，同比增長 18.7%，主要得益於 MCU、其他電源管理、閃存及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 8,570 萬美元，同比增長 51.9%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲其他地區的銷售收入 2,820 萬美元，同比增長 5.2%，主要得益於 MCU 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求下降所抵消。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 2,180 萬美元，同比增長 43.2%，主要得益於智能卡芯片、IGBT 及 MCU 產品的需求增加。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵包括中國台灣及日本。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二六年	二零二六年	二零二五年	二零二五年	同比	同比
	第一季度 千美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	第一季度 千美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	千美元	%
嵌入式非易失性存儲器	184,610	27.9 %	130,290	24.1 %	54,320	41.7 %
獨立式非易失性存儲器	57,098	8.6 %	42,875	7.9 %	14,223	33.2 %
功率器件	170,919	25.9 %	162,751	30.1 %	8,168	5.0 %
邏輯及射頻	74,381	11.3 %	66,787	12.3 %	7,594	11.4 %
模擬與電源管理	173,917	26.3 %	138,234	25.6 %	35,683	25.8 %
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.846 億美元，同比增長 41.7%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 5,710 萬美元，同比增長 33.2%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度功率器件銷售收入 1.709 億美元，同比增長 5.0%，主要得益於 IGBT 及通用 MOSFET 產品需求增加，部分被超級結產品的需求下降所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 7,440 萬美元，同比增長 11.4%，主要得益於邏輯及 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.739 億美元，同比增長 25.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二六年 第一季度 % (未經審核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	179,374	27.1 %	124,280	23.0 %	55,094	44.3 %
90nm 及 95nm	167,479	25.3 %	128,864	23.8 %	38,615	30.0 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	70,751	10.7 %	54,059	10.0 %	16,692	30.9 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	34,071	5.2 %	29,938	5.5 %	4,133	13.8 %
0.25 μ m	1,397	0.2 %	3,517	0.7 %	(2,120)	(60.3)%
0.35 μ m 及以上	207,853	31.5 %	200,279	37.0 %	7,574	3.8 %
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度 65nm 及以下工藝技術節點的銷售收入 1.794 億美元，同比增長 44.3%，主要得益於其他電源管理及閃存產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.675 億美元，同比增長 30.0%，主要得益於 MCU、其他電源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 7,080 萬美元，同比增長 30.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,410 萬美元，同比增長 13.8%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 140 萬美元，同比下降 60.3%，主要由於功率器件及邏輯產品的需求下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.079 億美元，同比增長 3.8%，主要得益於 IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求下降所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二六年 第一季度 % (未經審核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
消費電子	444,356	67.2 %	348,100	64.3 %	96,256	27.7 %
工業及汽車	143,150	21.7 %	119,878	22.2 %	23,272	19.4 %
通信	62,667	9.5 %	65,264	12.1 %	(2,597)	(4.0)%
計算	10,752	1.6 %	7,695	1.4 %	3,057	39.7 %
銷售收入總額	660,925	100.0 %	540,937	100.0 %	119,988	22.2 %

- 本季度消費電子作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 4.444 億美元，占銷售收入總額的 67.2%，同比增長 27.7%，主要得益於其他電源管理、MCU 及閃存產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.432 億美元，同比增長 19.4%，主要得益於 MCU、智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度通信類產品銷售收入 6,270 萬美元，同比下降 4.0%，主要由於模擬產品需求下降。
- 本季度計算類產品銷售收入 1,080 萬美元，同比增長 39.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)
總產能(折合 8 吋仟片晶圓)	489	413	486
總體產能利用率	99.7%	102.7%	103.8%

- 本季度末月產能 489,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 99.7%。

付運晶圓

折合 8 吋千片晶圓	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,453	1,231	1,448	18.0 %	0.3 %

- 本季度付運晶圓 1,453,000 片，同比上升 18.0%，環比上升 0.3%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以千美元計	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,358	2,214	3,791	6.5 %	(37.8)%
管理費用 ⁷	103,255	94,896	126,374	8.8 %	(18.3)%
經營開支	105,613	97,110	130,165	8.8 %	(18.9)%

- 經營開支 1.056 億美元，同比上升 8.8%，主要由於無錫新生產線的營運費用上升；環比下降 18.9%，主要由於人工開支下降。

其他(損失)/收入淨額

以千美元計	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,229	3,513	3,932	(8.1)%	(17.9)%
利息收入	10,394	15,619	15,228	(33.5)%	(31.7)%
匯兌收入/(損失)	5,105	(16,199)	7,014	(131.5)%	(27.2)%
分占聯營公司溢利	153	652	1,261	(76.5)%	(87.9)%
財務費用	(27,681)	(23,301)	(8,414)	18.8 %	229.0 %
政府補貼	5,634	11,231	16,280	(49.8)%	(65.4)%
其他	718	191	(1,191)	275.9 %	(160.3)%
其他(損失)/收入淨額	(2,448)	(8,294)	34,110	(70.5)%	(107.2)%

- 其他損失淨額 240 萬美元，同比減少損失 70.5%，主要由於本期取得外幣匯兌收益而上年同期為外幣匯兌損失，部分被政府補貼及利息收入減少和財務費用上升所抵消。上季度為其他收入淨額 3,410 萬美元，主要由於財務費用上升及政府補貼下降。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金使用分析

以千美元計	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	130,427	50,186	246,026	159.9 %	(47.0)%
投資活動所用現金流量淨額	(856,988)	(494,291)	(652,811)	73.4 %	31.3 %
融資活動所得現金流量淨額	638,664	59,137	1,361,101	980.0 %	(53.1)%
外匯匯率變動影響淨額	61,962	5,771	34,759	973.7 %	78.3 %
現金及現金等價物變動影響淨額	(25,935)	(379,197)	989,075	(93.2)%	(102.6)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.304 億美元，同比上升 159.9%，主要由於客戶收款上升；環比下降 47.0%，主要由於收到的政府補助下降及支付的人工開支上升。
- 投資活動所用現金流量淨額 8.570 億美元，其中包括固定資產投資支出 9.249 億美元，部分被收到定期存款 5,780 萬美元，利息收入 1,000 萬美元及設備處置款 10 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 6.387 億美元，其中提取銀行借款 6.494 億美元及員工行權發行股份收到 330 萬美元，部分被支付利息 1,210 萬美元、支付租賃負債 110 萬美元及償還銀行借款 80 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零二六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二五年 (已審核)
資產總額	14,947,323	14,453,772
負債總額	5,662,963	5,289,541
所有者權益總額	9,284,360	9,164,231
資產負債率 ⁸	37.9%	36.6%

資本開支

以千美元計	二零二六年 第一季度 (未經審核)	二零二五年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	38,725	74,527
華虹 12 吋	886,146	558,847
合計	924,871	633,374

- 本季度資本開支 9.249 億美元，其中 8.861 億美元用於華虹 12 吋，3,870 萬美元用於華虹 8 吋。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零二六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二五年 (已審核)
已竣工待售物業	218,918	215,511
存貨	533,311	544,368
貿易應收款項及應收票據	313,053	282,053
預付款項、其他應收款項及其他資產	661,570	561,328
應收關聯方款項	14,153	10,135
已凍結及定期存款	44,646	99,494
現金及現金等價物	4,867,873	4,893,808
流動資產總額	6,653,524	6,606,697
貿易應付款項	270,387	330,370
其他應付款項及暫估費用	735,491	1,008,586
計息銀行借款	811,820	403,748
租賃負債	4,652	3,229
政府補助	90,371	89,049
應付關聯方款項	4,996	6,225
應付所得稅	17,912	15,014
流動負債總額	1,935,629	1,856,221
淨營運資金	4,717,895	4,750,476
速動比率	3.0x	3.1x
流動比率	3.4x	3.6x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	41	37
存貨周轉天數	84	83

- 貿易應收款項及應收票據 由上季度末的 2.821 億美元上升至本季度末的 3.131 億美元，主要由於銷售收入增加。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產 由上季度末的 5.613 億美元上升至本季度末的 6.616 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 已凍結及定期存款 由上季度末的 9,950 萬美元下降至本季度末的 4,460 萬美元，主要由於定期存款減少。
- 貿易應付款項 由上季度末的 3.304 億美元下降至本季度末的 2.704 億美元，主要由於本期支付供應商款項增加。
- 其他應付款項及暫估費用 由上季度末的 10.086 億美元下降至本季度末的 7.355 億美元，主要由於本季度支付的資本支出上升。
- 計息銀行借款 由上季度末的 4.037 億美元上升至本季度末的 8.118 億美元，主要由於長期銀行借款的一年內到期部分增加。D'd'd
- 淨營運資金 本季度末 47.179 億美元，流動比率 3.4。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 41 天。
- 存貨周轉天數 84 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二六年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二五年 (未經審核)
銷售收入	660,925	540,937	659,882
銷售成本	(574,866)	(490,940)	(574,418)
毛利	86,059	49,997	85,464
其他收入及收益	25,100	30,563	44,107
投資物業的公平值損失	-	-	(2,844)
銷售及分銷費用	(2,358)	(2,214)	(3,791)
管理費用	(103,255)	(94,896)	(126,374)
其他費用	(20)	(16,208)	-
財務費用	(27,681)	(23,301)	(8,414)
分占聯營公司溢利	153	652	1,261
稅前損失	(22,002)	(55,407)	(10,591)
所得稅抵免/(開支)	4,735	3,245	(8,069)
期內損失	(17,267)	(52,162)	(18,660)
以下各方應占：			
母公司擁有人	20,929	3,750	17,454
非控股權益	(38,196)	(55,912)	(36,114)
持有人應占每股盈利			
基本	0.012	0.002	0.010
攤薄	0.012	0.002	0.010
用於計算持有人應占每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,737,629,193	1,721,931,435	1,736,132,077
用於計算持有人應占每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,737,760,230	1,728,142,630	1,736,269,454

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二五年 (已審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	7,105,886	6,676,442	5,967,555
投資物業	223,247	219,772	209,257
使用權資產	64,125	64,482	76,359
無形資產	32,834	35,509	29,122
於聯營公司的投資	152,751	150,222	140,650
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	486,369	478,799	289,722
長期預付款項	228,587	221,849	57,989
遞延所得稅資產	-	-	380
非流動資產總額	8,293,799	7,847,075	6,771,034
流動資產			
已竣工待售物業	218,918	215,511	221,061
存貨	533,311	544,368	468,597
貿易應收款項及應收票據	313,053	282,053	286,763
預付款項、其他應收款項及其他資產	661,570	561,328	411,207
應收關聯方款項	14,153	10,135	16,520
已凍結存款及定期存款	44,646	99,494	31,669
現金及現金等價物	4,867,873	4,893,808	4,079,935
流動資產總額	6,653,524	6,606,697	5,515,752
流動負債			
貿易應付款項	270,387	330,370	255,321
其他應付款項及暫估費用	735,491	1,008,586	759,177
計息銀行借款	811,820	403,748	329,972
租賃負債	4,652	3,229	7,543
政府補助	90,371	89,049	57,700
應付關聯方款項	4,996	6,225	12,724
應付所得稅	17,912	15,014	18,620
流動負債總額	1,935,629	1,856,221	1,441,057
流動資產淨額	4,717,895	4,750,476	4,074,695
總資產減流動負債	13,011,694	12,597,551	10,845,729
非流動負債			
計息銀行借款	3,085,413	2,787,096	1,948,409
租賃負債	13,476	15,679	15,160
遞延稅項負債	24,463	35,964	1,498
其他非流動負債	603,982	594,581	-
非流動負債總額	3,727,334	3,433,320	1,965,067
淨資產	9,284,360	9,164,231	8,880,662
權益和負債權益			
股本	4,987,537	4,987,482	4,957,182
儲備	1,743,223	1,625,181	1,315,995
本公司擁有人應占權益	6,730,760	6,612,663	6,273,177
非控股權益	2,553,600	2,551,568	2,607,485
權益總額	9,284,360	9,164,231	8,880,662

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日	於三月三十一日	於十二月三十一日
	二零二六年 (未經審核)	二零二五年 (未經審核)	二零二五年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前虧損	(22,002)	(55,407)	(10,591)
折舊及攤銷	214,606	172,126	195,876
應占聯營公司溢利	(153)	(652)	(1,261)
營運資金的變動及其它	(62,024)	(65,881)	62,002
經營活動所得現金流量淨額	130,427	50,186	246,026
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產專案	(924,871)	(510,851)	(633,374)
投資其他權益工具	-	-	(3,557)
收到政府對設備的補助	-	-	36,596
定期存款的減少/(增加)	57,794		(67,152)
其他投資活動所得現金流量	10,089	16,560	14,676
投資活動所用現金流量淨額	(856,988)	(494,291)	(652,811)
融資活動現金流量：			
提取銀行貸款	649,364	860,985	919,025
發行股份所得收益	3,343	13,077	4,740
償還銀行貸款	(828)	(811,156)	(136,107)
已付利息	(12,137)	(3,252)	(32,834)
支付租賃負債	(1,078)	(517)	(428)
收到政府對財務費用的補助	-	-	12,124
其他融資活動收到的現金	-	-	594,581
融資活動所得現金流量淨額	638,664	59,137	1,361,101
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(87,897)	(384,968)	954,316
期初現金及現金等價物	4,893,808	4,459,132	3,904,733
外匯匯率變動影響淨額	61,962	5,771	34,759
期末現金及現金等價物	4,867,873	4,079,935	4,893,808

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

白鵬(董事長兼總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承豔

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

承董事會命

華虹半導體有限公司

白鵬

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二六年五月十四日